

ガラス基板で高いピール強度が得られる

High peel strength to glass substrate

ガラス基板への無電解銅めっきプロセス

PLOPX™ プロセス

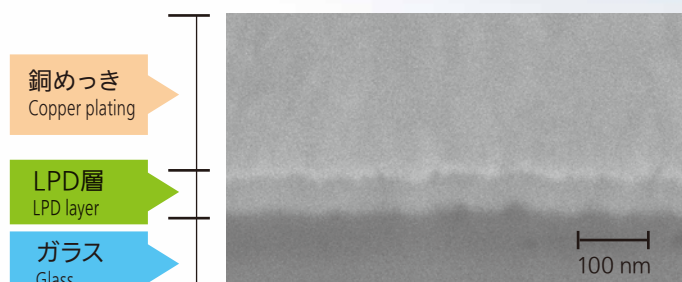
Electroless Copper Plating Process for Glass Substrate PLOPX PROCESS

お問い合わせは
Webへ!



- 液相析出法 (Liquid Phase Deposition; LPD法) により
金属酸化層を形成したガラス基板への無電解銅めっきプロセス
- ガラス基板に対して高いピール強度が得られる
- つきまわり性が良く、TGVへの析出性に優れる

- Electroless copper plating process for glass substrate: Form metal oxide by LPD (Liquid Phase Deposition) layer
- High peel strength to glass substrate
- High via-covering power, great deposition performance to TGV

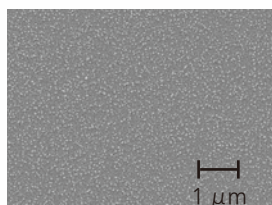


ガラス/LPD層/めっき断面SEM像
SEM image of cross section (Glass/LPD layer/Copper plating)

Ra=1.3 nm



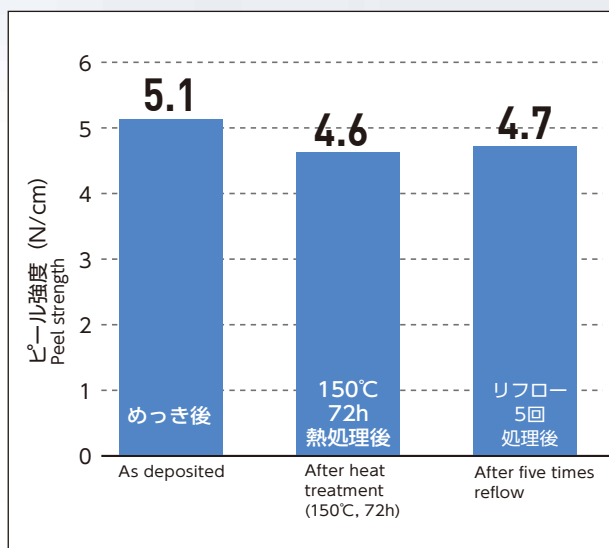
LPD層表面AFM像
AFM image of surface (LPD layer)



LPD層表面SEM像
SEM image of surface (LPD layer)

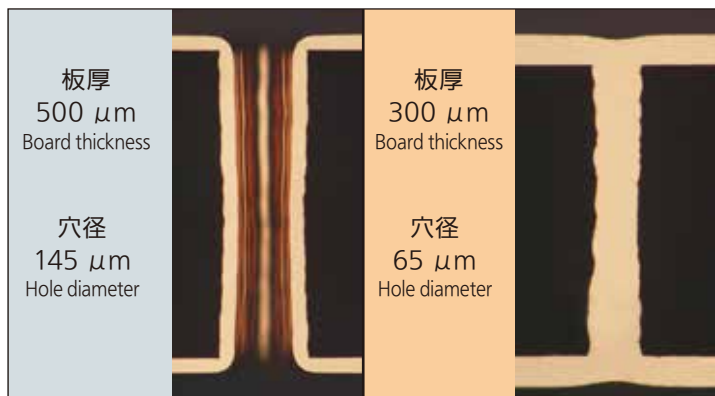
●ピール強度(初期、熱処理時)

リフロー: 250℃以上30秒 (最高到達温度: 270℃)
Reflow: over 250℃, 30 s, maximum temperature 270℃



スルーホールめっき析出性に優れる

Excellent deposition performance to through-hole



硫酸銅めっき後のTGV断面像
Cross section image of TGV after acid copper plating

処理工程 Process

